

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2018-042

江苏长电科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2017 年 年度报告的事后审核问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 18 日收到上海证券交易所下发的《关于对江苏长电科技股份有限公司 2017 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2018]0579 号，以下简称“《问询函》”）后，立即结合公司的实际情况对《问询函》进行了认真分析、研究、落实，现回复如下：

一、关于星科金朋集团

2015 年公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称大基金）与芯电半导体（上海）（以下简称芯电半导体）有限公司共同出资设立的苏州长电新科与苏州长电新朋收购了新加坡封测公司星科金朋。2017 年，公司收购了产业基金持有的苏州长电新科 29.41% 股权、苏州长电新朋 22.73% 股权以及芯电半导体持有的苏州长电新科 19.61% 股权，以实现对长电新科和长电新朋 100% 持股，最终实现对星科金朋 100% 持股。根据产业基金、芯电半导体与公司签订的协议，长电新科、长电新朋于 2017-2019 利润补偿期间实现的经审计合并净利润之和均不低于 10.1 亿元。根据报告分部的财务信息，星科金朋及下属子公司 2017 年对外交易收入 78.64 亿元、净利润为亏损 7.65 亿元，且近三年持续亏损。因收购星科金朋集团形成的商誉账面价值为人民币 25.11 亿元，且三年均未计提商誉减值准备。

1、近年来半导体封测行业进入景气周期，而星科金朋业绩未见起色，请公司补充披露：（1）结合行业趋势、同行业可比公司经营情况，针对性说明星科金朋集团行业地位和核心竞争力，包括但不限于行业排名、主要产品收入、成本、

主要客户、产销量和市场占有率等，并说明星科金朋集团持续亏损的情况是否符合行业趋势；（2）结合国内外竞争情况、上下游情况和其运营状况，分析星科金朋集团连续多年大幅亏损的原因；（3）2017年度实现利润与业绩承诺差距较大，分析说明星科金朋集团利润补偿协议完成的可能性，说明拟采取的改善经营的应对措施及后续相关业务的发展战略安排。

回复说明：

一、星科金朋集团行业地位和核心竞争力

1、行业发展趋势、同行业可比公司经营情况

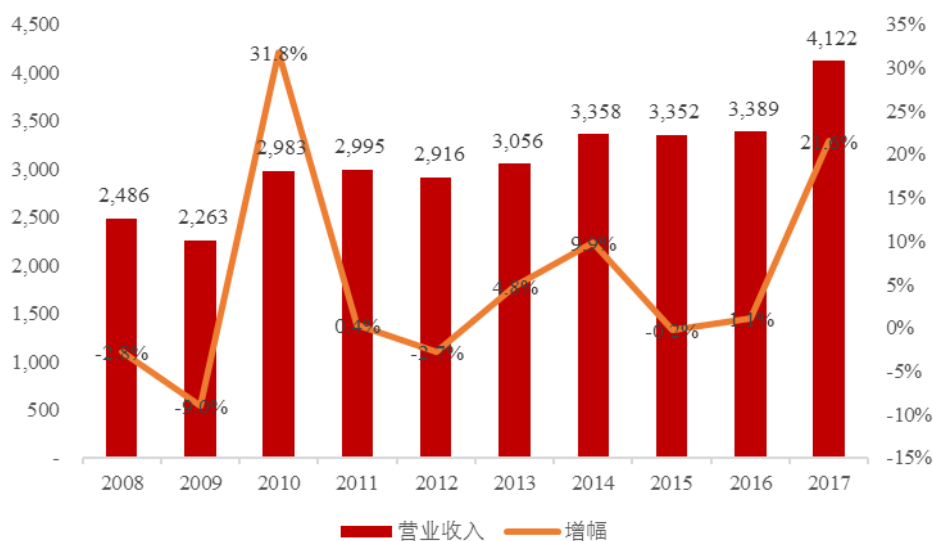
星科金朋主要从事集成电路封装、测试，属于半导体行业。

（1）全球半导体行业发展趋势

近年全球半导体行业总体呈增长趋势，虽然2015年略有下滑，2016年下半年开始回暖，2017年随着存储器（Memory）、逻辑芯片（Logic）和微芯片（micro-ICs）等的快速增长，全球半导体行业总营收达到4,122.21亿美元，同比增长21.6%，其中主要存储器中的DRAM和NAND flash由于价格等因素分别同比增长了76.8%和47.5%。

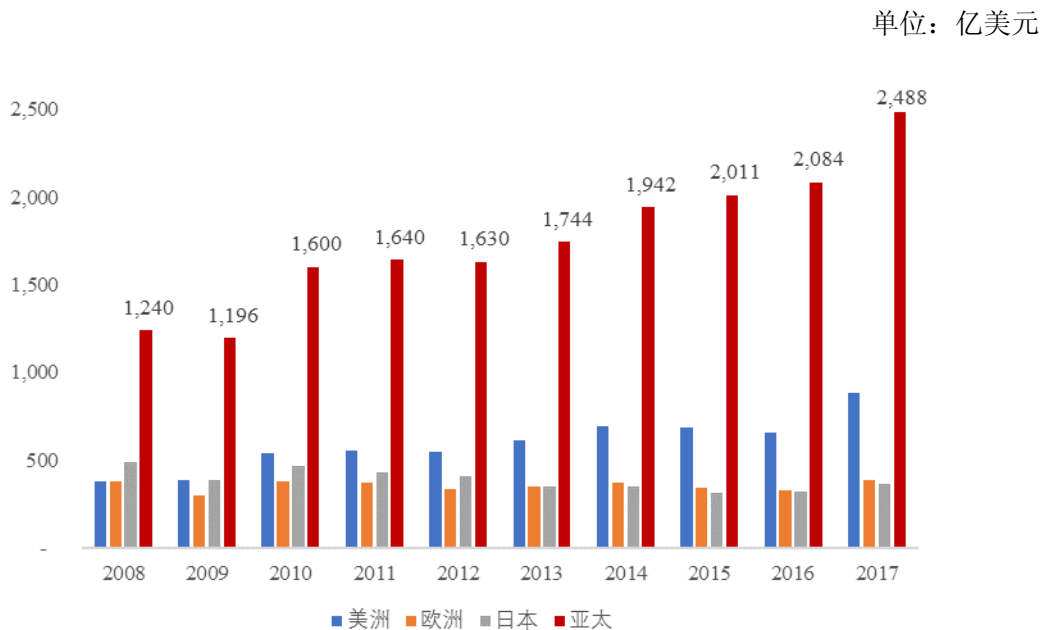
2008年至2017年全球半导体营业收入及趋势

单位：亿美元



数据来源：Wind

分地区而言，2017年全球半导体市场中，美洲市场增长35.0%、欧洲市场增长17.1%、亚太与其他地区增长16.4%、日本增长13.3%，中国市场增长22.2%。亚太地区尤其是中国仍然保持着快速增长的态势。2017年全球半导体地区营业收入及其增长趋势情况如下图所示：



资料来源：Wind

(2) 国内半导体行业发展状况

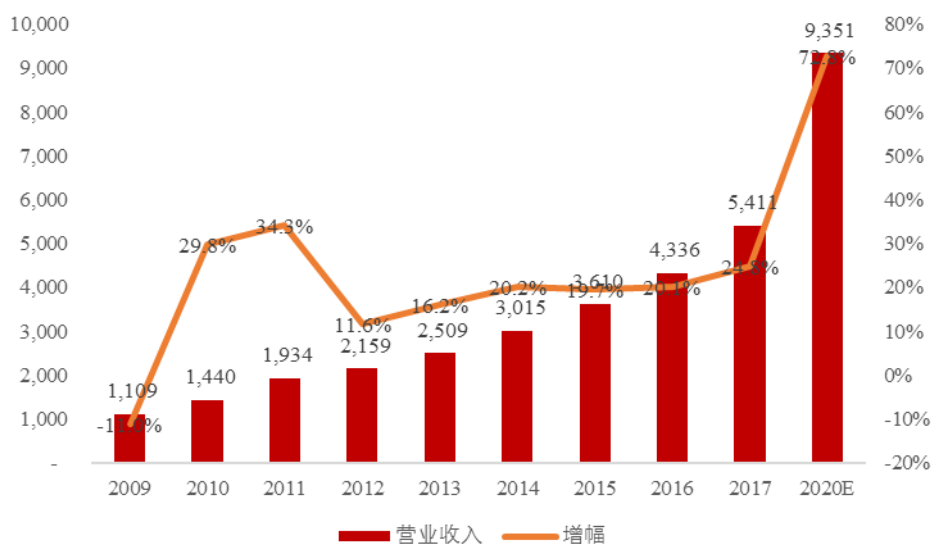
我国是电子产品的重要生产地，其半导体市场需求约占全球60%，但其半导体销量的全球份额（包括在华外国半导体公司的投资额）仅为20%左右。我国半导体市场需求的满足较大程度依赖于进口，半导体的进出口逆差较大，2014年逆差额为1,567亿美元，2015年逆差额达到1,614亿美元，2016年逆差额达到1,657亿美元。为尽快缓解国内对进口半导体需求较大的局面，国家陆续出台多项半导体支持政策。

集成电路产业是我国信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2011年，我国集成电路营业收入为1,934亿元，到2017年时达到5,411亿元，复合增长率超过20%。考虑到国家对半导体行业的大力支持和《国家集成电路产业发展推进纲要》等政策的发布，预计我国集成电路市场增长将持续。《国家集成电路产业发展推进纲要》指出：“到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过

20%，企业可持续发展能力大幅增强”，按照2018年至2020年，年增长率稳定在20%的趋势计算，到2020年，中国集成电路营业收入将达到9,351亿元。

中国集成电路行业营业收入与未来预测

单位：亿元



资料来源：Wind

根据中国半导体行业协会统计，2017年，我国集成电路封装测试行业营业收入达到1,889.7亿元，较2016年上升20.80%。

(3) 同行业可比公司经营情况

星科金朋可比公司包括全球排名前列的台湾日月光（ASE）、美国安靠（Amkor）、台湾矽品（SPIL）。

①日月光（ASE）

日月光集团成立于1984年，1989年在台湾证券交易所上市，2000年美国上市。目前，日月光集团在中国大陆的上海市（ASESH）、苏州市（ASEN）、昆山市（ASEKS）和威海市（ASEWH）设有半导体封装、测试、材料、电子厂。日月光集团为全球最大的半导体制造服务公司之一，专注于提供半导体客户完整之封装及测试服务，包括晶片前段测试及晶圆针测至后段之封装、材料及成品测试的一元化服务。

②安靠（Amkor）

安靠成立于1968年，公司总部、研发中心、产品及市场部位于美国亚利桑

那州的钱德勒。安靠在韩国、菲律宾和中国台湾各有 3 家工厂，日本、马来西亚和中国上海各有 1 家。除了在太平洋沿岸的工厂外，安靠公司在美国、日本、新加坡、英国、中国台湾和法国等地方均有生产及销售代表处。

③矽品 (SPIL)

矽品成立于 1984 年 5 月，主要营业项目为从事各项集成电路封装之制造、加工、买卖及测试等相关业务。矽品一向致力于集成电路封装及测试之设计、制造与技术服务，并不断藉由质量改善及技术创新以满足顾客需求，使公司成为创造高附加价值之专业供应者，发展至今已成为全球前列的专业封装测试厂。

最近三年，上述三家可比企业主要经营数据如下：

单位：万元人民币

项目	日月光	安靠	矽品	长电科技	
营业收入	2017 年	6,380,993.34	2,735,540.87	1,821,394.94	2,385,551.24
	2016 年	5,882,519.89	2,701,014.60	1,636,088.46	1,915,452.77
	2015 年	5,595,225.09	1,873,145.80	1,622,385.24	1,080,702.38
归属于母 公司股东 的净利润	2017 年	505,042.38	170,351.51	212,569.62	34,334.68
	2016 年	457,138.37	113,898.60	177,976.39	10,633.44
	2015 年	395,266.72	36,891.44	219,089.24	5,199.75

数据来源：wind

注：长电科技数据包含星科金朋。

2、星科金朋集团行业地位和核心竞争力

(1) 星科金朋集团行业地位

星科金朋是国际领先的先进封装测试服务提供商。2017 年，星科金朋营业收入达到 116,062.51 万美元，星科金朋的主要客户基本涵盖全球前二十大半导体设计公司。据拓璞产业研究院统计，2017 年，长电科技（包括星科金朋）市场占有率达到 11.9%。

2017 年、2016 年及 2015 年，星科金朋主要产品收入数据如下：

单位：万美元

项目	2017	2016	2015
先进封装	57,567	60,368	66,659
焊线封装	35,051	32,452	35,337
测试	23,445	23,496	31,857

（2）星科金朋集团核心竞争力

星科金朋的核心竞争力主要体现在以下方面：

①行业领先的高端封装技术

星科金朋拥有行业领先的高端封装技术能力（包括 SiP、eWLB、TSV、3D 封装、PiP、PoP 等），具备与封测行业全球前列的日月光、安靠、矽品相竞争的技术实力。特别是在半导体封测行业未来发展的两大主流方向，即晶圆级扇出型封装（Fan-Out WLP）和系统级封装（SiP）两个领域，星科金朋所拥有的 eWLB 和 SiP 在技术上、规模上都处于全球领先地位。

②持续的研发能力及丰富的专利技术

星科金朋 2015 年、2016 年、2017 年研发支出分别为 3,503.90 万美元、3,060.60 万美元、3,476.70 万美元。过去几年，星科金朋对面向高端智能手机和平板电脑市场、新兴市场芯片组的先进封装和一站式测试业务，对晶圆级封装、系统级封装和一站式测试服务解决方案等领域进行了持续研发投入。截至 2017 年 12 月 31 日，星科金朋共拥有 2,581 项专利。其中，美国专利商标局（PTO）授予或批准的 1,750 项，新加坡、韩国及其他国家注册或获批准的 831 项，在全球集成电路封测外包服务提供商（OSAT）中处于领先地位。

星科金朋在 IEEE 发布的《2017 年专利实力评鉴》（2017 Patent Power Scorecards）中位列全球半导体制造企业 10 强，这是星科金朋连续第八年获此殊荣。

③国际一线客户群体

星科金朋在全球拥有庞大而又多元化的客户群，全球前二十大半导体公司绝大部分为其客户，涵盖集成电路制造商、无晶圆厂公司及晶圆代工厂，并且许多客户都是各自领域的市场领导者。

星科金朋的客户主要来自通信、计算机、电子消费品三个终端市场。因为其拥有高级阵列和堆叠封装技术专长及强大的混合信号/射频集成电路测试能力，销售收入主要来自通信终端市场，2017 年占比 63.80%。

星科金朋还拥有广泛的地区覆盖，客户遍布世界主要地区。2017年，美国、亚洲、欧洲客户营收占比分别为 56.67%、29.75%、13.58%。星科金朋在战略性半导体市场所在国家建立了成熟的业务，并且接近主要的晶圆制造枢纽，能够为客户提供全集成、多工位（multi-site）、端到端封测服务。

④领先的行业地位

星科金朋是集成电路封测外包行业国际领先企业，具有规模优势，产能范围广泛。自 1995 年开始运营以来，星科金朋现已成长为集成电路封测外包行业领先企业。在资金密集型半导体行业，针对大规模产出配置固定成本的能力是一项重要优势。与长电科技合并后，星科金朋作为国际一流企业的地位进一步得到巩固，特别是利用长电科技在我国市场的影响力拓展我国业务。

⑤先进信息化管理系统的优势

星科金朋发展时间较长，目前拥有先进的信息化管理系统及 IT 支持。整个公司信息化管理系统先进，相关数据存储及追溯系统相对完善，有较全面的系统防呆功能，处于业界领先水平。

3、星科金朋集团持续亏损的情况是否符合行业趋势

星科金朋最近三年持续亏损，主要原因是个别大客户订单大幅下滑、工厂搬迁等原因所致，该等因素主要是收购后整合过渡期的自身阶段性因素，与全球半导体行业发展趋势并不完全一致（具体请见本回复下文“二、星科金朋集团连续大幅亏损的原因”）。随着 SCC 搬迁完成，JSCC 生产逐步恢复，2018 年第一季度星科金朋营业收入同比增长了 13.84%，经营情况正逐步好转。

二、星科金朋集团连续大幅亏损的原因

集成电路封装测试行业属于资金密集型、技术密集型行业，特别是先进封装技术，对应的机器设备等固定资产账面价值较高。最近三年末星科金朋固定资产占总资产比例均超过 50%，与之相应的，其机器设备折旧费用、厂房和设备租赁费用等固定成本占主营业务成本的比例也较大。

要约收购前的 2014 年星科金朋即处于盈亏平衡附近，2015 年特别是 2015

年第三季度开始，订单量及营业收入的下降直接导致毛利大幅下滑，再加上财务费用较高，导致星科金朋出现持续亏损。具体如下：

1、韩国厂 SCK、上海厂 SCC 先后搬迁

(1) SCK 搬迁原因

由于原厂房承租协议到期，厂房被收回，SCK 于 2014-2015 年上半年进行搬迁，SCK 搬迁后目前主要生产地位于韩国仁川，主要在位于韩国仁川的 3 幅土地上开展。

(2) SCC 搬迁原因

由于上海市青浦区城市建设总体规划和上海市政府关于西虹桥地区整体开发建设需要等原因，上海市青浦区土地储备中心整体征收了星科金朋上海工厂 SCC 位于上海市青浦区徐泾镇华徐公路 188 号的国有出让土地。

2014 年 12 月和 2015 年 1 月，SCC 分别与上海市青浦区土地储备中心及上海青浦区徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室、上海青浦区徐泾镇人民政府签署了搬迁相关协议。根据协议约定，SCC 需于 2017 年第三季度末之前搬迁。

(3) 搬迁造成的影响

工厂搬迁一方面导致搬迁过程中客户订单中断，出现客户转单；另一方面新工厂需完成客户产品导入、认证、测试等过程后方可逐步恢复生产；并且，搬迁过程中工厂两地运营、新工厂的新员工培训等也导致成本费用大幅增加。

以 SCC 搬迁为例，其大规模搬迁于 2016 年 11 月开始，至 2017 年 9 月搬迁结束。2017 年，一方面 SCC 和 JSCC 工厂两地运营，运营费用成倍增加，JSCC 新厂大量新招员工培训成本较高，导致成本费用大幅增加，超出预期。另一方面，JSCC 新员工招聘数量多，招聘进度和培训工作进度不及预期，新生产线产能爬坡过程较慢，前三季度生产效率不足，订单量和销售恢复延后。上述两方面原因导致搬迁对经营影响超出预期。

2、第一大客户的订单量下降

2015 年第三季度开始，星科金朋原第一大客户订单量大幅下滑，其下滑原

因主要包括两方面：一是因为该客户的上游客户需求有所下降；二是星科金朋韩国厂 SCK 于 2014-2015 年上半年搬迁、上海厂 SCC 于 2015 年下半年确定计划搬迁，导致该客户转单，2014 年至 2015 年、2016 年、2017 年，星科金朋从该客户取得的销售收入绝对金额大幅下降，其销售收入占星科金朋营业收入比重也由 25.87% 下降至 18.74%、17.13% 和 15.27%。

3、财务费用大

星科金朋被公司要约收购后进行了债务重组，资产负债率较高，且财务费用率高，财务费用大。

2017 年、2016 年及 2015 年，星科金朋资产负债率及财务费用情况如下：

单位：万美元

项目	2017 年 12 月 31 日 /2017 年	2016 年 12 月 31 日 /2016 年	2015 年 12 月 31 日 /2015 年
资产负债率	60.15%	65.42%	61.81%
利息费用	6,889	6,869	5,424

注：1、以上数据经新加坡安永审计，未进行合并调整；

2、上述星科金朋资产负债率及财务费用不含 2 亿美元永续证券及利息。

三、拟采取的改善经营的应对措施及后续相关业务的发展战略安排，星科金朋集团利润补偿协议完成的可能性

要约收购完成后，公司在保持星科金朋资产、业务及人员相对独立和稳定的基础上，对其管理、销售、采购、人力资源等方面进行了全面整合，具体整合工作请参见本回复之问题 2。

在此基础上，针对星科金朋经营状况，公司拟采取的改善经营的应对措施及后续相关业务的发展战略安排如下：

1、销售方面：公司改组了星科金朋销售团队，并改进其销售激励机制，充分调动并发挥销售团队的积极性，不断拓展原有客户和新客户；同时通过公司统一销售管理，将中国客户订单导入星科金朋；

2、运营方面：公司在星科金朋各工厂进一步开展降本增效专项，从采购成本、生产制造成本、人力成本等各个方面多管齐下，也针对提升自动化水平开展专项研究，降低工厂运营成本；同时，严格控制星科金朋总部各项费用支出；

3、 财务方面：制定债务优化方案，减少星科金朋的利息费用等。

具体到星科金朋下属三家工厂的发展战略安排如下：

1、新加坡厂 SCS 定位于全球领先的 eWLB 扇外型晶圆级封装（Fan-Out WLP）的研发和生产基地，将抓住晶圆级扇外型封装 eWLB 的全球技术领先优势，扩产上量。原第一大客户订单量通过 eWLB 项目部分回升，同时 eWLB 项目正导入客户新产品，提升产量，进而提升盈利能力。

2、韩国厂 SCK 定位于以 FCCSP+POP+SiP 为主，正积极营销原有大客户新产品导入，同时加大了本地客户的开发和导入，通过倒装（FC）相关业务订单逐步恢复。

3、江阴新厂 JSCC 将与同位于江阴城东厂区的长电先进的芯片凸块 Bumping 配套，形成一站式 FC 服务产业链，并保留高端焊线 Wirebond 产品特色。目前 JSCC 客户订单恢复良好，新客户导入顺利，特别是倒装（FC）相关业务订单饱满。JSCC 正加快对新员工的培训，加紧产能爬坡，提升生产效率，应对正在恢复和新增的客户订单。

目前公司正严格执行对星科金朋的各项改善经营措施和业务发展战略安排，尽快改善星科金朋经营状况。同时，产业基金、芯电半导体将严格按照与公司签署的补充协议约定，协议期满后履行双方关于长电新科、长电新朋于 2017-2019 三年期间利润的补偿安排。

2、据年报披露，报告期公司对星科金朋进行了深度整合，实行扁平化管理，提高了管理效率和执行力。请详细披露公司对星科金朋集团的控制和业务整合情况，包括但不限于经营管理决策程序、财务制度、公司派驻董事或高级管理人员、技术团队研发成果情况、生产经营流程的整合情况等。

回复说明：

2015 年下半年收购完成后，公司在保持星科金朋资产、业务及人员相对独立和稳定的基础上，对其管理、销售、采购、人力资源等方面进行了全面整合。

其中主要整合工作如下：

1、改变经营机制，实行扁平化管理

要约收购完成后，公司改选了星科金朋董事会，委派了 CEO、CFO 和法务长，保证了总部对星科金朋的控制权以及重大事项的决策权。

公司保持了星科金朋各重要子公司资产及机构独立运营的模式，履行母公司对子公司的管理职能，并且将各经营实体（BU）SCK、SCS、JSCC 从单纯生产基地转变成为权责利相结合的利润中心，由公司总部制定绩效考核指标（KPI），各 BU 总经理对经营绩效负责，并赋予与责任对等的决策权。目前星科金朋三个工厂均已形成独立的利润中心，具备相对独立的技术研发、生产、采购、销售、售后服务等经营自主权，以满足国际、国内各层级客户业务需求。

2、完善财务制度等内控制度建设

根据上市公司风险管控的要求，公司总部对星科金朋推行风险管控体系建设，建立了内部审计制度，规定了重大财务投资决策中星科金朋管理层的决策权限和决策流程。公司总部相关职能部门对星科金朋对应管理条线实施管理控制。

3、技术团队研发成果情况

星科金朋具备 eWLB、SiP 等全球领先的封测技术，并已完成产业化前期开发。收购完成后，公司通过充分论证，认为完全符合芯片封装的“高密度、高速率、高散热、低功耗、低成本”的要求，是轻薄短小移动智能终端产品发展方向的最佳技术路径选择。公司管理层设立了重点项目专项管理 CIP 计划，于 2016 年开始进行两个项目投资。SiP 项目由 JSCC 实施，于 2017 年实现营业收入 75,555.39 万美元，实现净利润 2,272.24 万美元。eWLB 项目由 SCS 实施，目前仍在建设过程中。重大项目的实施代表未来先进封装发展方向，使前期研发的先进封测技术产业化、规模化。与此同时，长电科技完成对星科金朋收购后，星科金朋研发团队持续投入对现有产品及新技术的研发；2017 年，星科金朋研发团队进行了 30 多项新产品的研发。

4、生产经营流程的整合情况

通过在工厂实施阿米巴管理模式，公司重新梳理了总部和各个子公司管理制度和管理流程，完善内控体系并控制成本。

销售层面，公司通过交叉销售，为星科金朋导入国内重点客户，同时，将星科金朋各子公司产品线的销售业绩与个人绩效挂钩，提高员工积极性。

生产层面，公司调整了包括星科金朋下属三个生产基地在内的全球七大生产基地的产品发展规划和战略定位，形成各自的细分市场核心竞争优势。同时，通过产能调配、资源整合、业务划分，提高产能利用率。

采购层面，公司总部加强运行协调，实行各生产基地集中采购，强化对原材料供应商和设备供应商的管理，提高采购议价能力，降低采购成本。

5、降低星科金朋资产负债率和财务费用

公司将制定债务优化方案，降低星科金朋资产负债率和财务费用。同时，产业基金、芯电半导体（最终股东为中芯国际）已经成为公司主要股东，将持续支持优化星科金朋财务状况。

3、请公司结合目前星科金朋集团生产经营和公司对其整合协同情况等补充披露：（1）其连续三年亏损但未计提商誉减值准备的原因、依据及合理性；（2）近三年商誉减值测试中关键参数、假设及未来现金流预测的数据和确定依据，请公司年审会计师核查并发表意见。

回复说明：

一、星科金朋集团连续三年亏损但未计提商誉减值准备的原因、依据及合理性

1、商誉的形成

公司的商誉为 2015 年 8 月 5 日（购买日）收购星科金朋 100% 股权产生，公司聘请了第三方评估机构新加坡 Duff & Phelps Corporation 对收购标的星科金朋购买日可辨认净资产公允价值进行了评估，依照企业会计准则对星科金朋各项可辨认资产、负债及或有负债均逐项单独予以确认，购买日各项可辨认资产公允价

值较账面值的增值部分直接归集到对应的具体资产项目。新加坡 Duff & Phelps Corporation 作为全球领先的评估与公司财务顾问，主要向客户提供评估、交易咨询、财务重组等领域的专业服务。

在公司编制 2015 年度合并财务报表时，由于对上述收购交易相关可辨认资产及负债的评估工作尚未完全完成，合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值只能暂时确定。公司依据《企业会计准则第 20 号—企业合并》，对合并中取得的星科金朋的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以所确定的暂时价值为基础进行确认和记录，将自购买日（2015 年 8 月 5 日）算起 12 个月内对可辨认资产、负债及或有负债的暂时性价值进行调整。截至 2015 年 12 月 31 日，星科金朋可辨认净资产于购买日的暂定公允价值为 36,613.31 万美元（折合人民币 224,022.21 万元），与实际支付的投资成本 74,520.49 万美元（折合人民币 455,961.10 万元）之间差额 37,907.18 万美元（折合人民币 231,938.88 万元）为购买产生的暂定商誉。

公司在编制 2016 年度合并财务报表时，已完成了对上述收购交易相关可辨认资产及负债的评估工作，依照《企业会计准则第 20 号—企业合并》对合并中取得的星科金朋的各项可辨认资产、负债及或有负债按评估工作完成后确定的公允价值进行确认和记录，并相应对上述可辨认资产、负债及或有负债的暂时性价值进行了调整。调整后，截至 2016 年 12 月 31 日，星科金朋可辨认净资产于购买日的公允价值为 36,097.02 万美元（折合人民币 220,863.20 万元），与公司实际支付的投资成本 74,520.49 万美元（折合人民币 455,961.10 万元）之间差额确认为购买产生的商誉 38,423.48 万美元（折合人民币 235,097.90 万元）。

2、星科金朋亏损及整合情况

集成电路封装测试行业属于资金密集型、技术密集型行业，特别是先进封装技术，对应的机器设备等固定资产账面价值较高。星科金朋最近三年固定资产占总资产比例均超过 50%，与之相应的，其机器设备折旧费用、厂房和设备租赁费用等固定成本占主营业务成本的比例也较大。要约收购前的 2014 年星科金朋即处于盈亏平衡附近，2015 年特别是 2015 年第三季度开始，订单量及营业收入的下降直接导致毛利大幅下滑，再加上财务费用较高，导致星科金朋连续三年

亏损。

2015 年下半年收购完成后，公司在保持星科金朋资产、业务及人员相对独立和稳定的基础上，对其管理、销售、采购、人力资源等方面进行了全面整合。

关于星科金朋的亏损原因及公司对星科金朋整合的具体情况，请参见本回复问题 1 及问题 2。

二、近三年商誉减值测试中关键参数、假设及未来现金流预测的数据和确定依据

根据企业会计准则规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

资产组的可收回金额是根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司在 5 年的时间范围内对资产剩余使用寿命内整个经济状况进行最佳估计，根据公司批准的财务预算为基础，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额确定资产预计未来现金流量的现值。

在对上述商誉于 2017 年 12 月 31 日进行减值测试时，公司聘请了北京中天衡平国际资产评估有限公司进行减值测试，星科金朋资产组的可收回金额是以管理层批准的财务预算预测的未来现金流量的现值所确定。公司认为该等财务预算及未来现金流量系公司管理层于 2017 年 12 月 31 日之最佳估计，考虑了该资产负债表日资产组历史财务数据、行业发展状况和资产组未来业务发展趋势。公司管理层对资产组 2017 年 12 月 31 日未来五年（自 2017 至 2021 年）的营业收入、各类成本、费用等进行了预测，自第六年后各年的收益假定保持与第五年（即 2021 年）相同，具体预测数据如下：

单位：千美元

项目/年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	永续期
收入	1,450,000.00	1,595,000.00	1,690,700.00	1,758,328.00	1,828,661.12	1,828,661.12
资本性支出	255,000.00	159,500.00	169,070.00	175,832.80	175,832.80	272,899.19
净利润	18,302.42	70,162.24	97,415.66	116,366.67	175,243.01	175,243.01
净现金流量	79,221.53	217,335.28	248,680.48	267,379.89	318,061.01	232,329.99
现金流量折现值	74,700.00	182,200.00	185,350.00	177,180.00	187,390.00	1,097,170.00
合计	1,903,990.00					

经测试，星科金朋资产组于 2017 年 12 月 31 日预计未来现金流量的现值为 190,399 万美元，包含商誉的资产组账面价值为 168,368 万美元（其中资产组账面价值 129,945 万美元，商誉账面价值 38,423 万美元），资产组预计未来现金流量现值高于包含商誉的资产组账面价值，因而无需计提减值准备。

商誉系一种长期资产，而长电科技收购星科金朋系依据公司高端国际化的长期发展战略所作出的决定。该次收购加速提升了公司行业地位及国际影响力，大幅提升了公司先进封装技术水平，使公司直接进入国际知名客户供应链及封测行业第一阵营，属于长期性、战略性的决策。星科金朋作为全球封测行业第一梯队企业，其领先封装技术、高端客户资源、国际化经营管理、信息化管理系统等核心竞争优势依然突出，2017 年第四季度经营状况已明显改善，公司对星科金朋的整合已初见成效，其具备良好的发展前景和盈利能力，从中长期看能够有利于公司整体竞争力和影响力的提升。

综上，公司管理层认为公司于 2017 年 12 月 31 日对商誉的减值测试是有效的，未计提减值准备。

三、年审会计师意见

会计师安永意见：在对长电科技 2017 年度合并财务报表进行审计过程中，我们取得了长电科技聘请的北京中天衡平国际资产评估有限公司对收购星科金朋所确认的商誉进行减值测试的评估报告，以及公司对星科金朋资产组进行商誉减值测试的工作底稿。我们结合资产组的实际经营情况以及市场前景的分析复核了现金流量的预测，我们的内部商业模型及价值估值专家对上述评估报告及公司评估结果进行复核，对减值测试过程中使用的模型及重要参数进行查验，未发现重大异常。我们认为长电科技上述商誉确认的会计处理在所有重大方面符合企业

会计准则的要求。

二、关于公司财务及生产经营情况

4、年报披露，公司 2017 年实现营业收入 238.56 亿元，同比增加 24.54%，但扣除非经常性损益后实现归母净利润-2.63 亿元，较去年同期-2.06 亿元增加亏损 0.57 亿元。报告期内长电本部营收比上年同期增长 15.66%，净利润比上年同期增长 46.05%。即公司扣非后亏损主要来自星科金朋业务分部，原长电本部经营状况良好。请公司补充披露：（1）结合政策、行业发展、同地区公司情况等，具体分析原长电业务分部业绩、收入实现大幅增长的原因；（2）结合产品、上下游、研发与管理等具体要素分析原长电与星科金朋集团业绩变化差异产生的原因；（3）请说明公司是否针对分部间业务发展不均的情况制定相关应对措施及经营安排。

回复说明：

一、原长电业绩大幅增长的原因

原长电主要指扣除 JSCK 及星科金朋集团后的其他长电科技所属的经营主体，2017 年，原长电实现营业收入 111.65 亿元，较 2016 年增长 23.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.98 亿元，较 2016 年增长 61.57%。国内封测行业其他上市公司也保持了高速增长。其中，通富微电（002156.SZ）在剔除收购影响后，原有业务营业收入达到 35.64 亿元，较 2016 年增长 25.05%；华天科技（002185.SZ）实现营业收入 70.10 亿元，较 2016 年增长 22.00%；晶方科技（603005.SH）实现营业收入 6.29 亿元，较 2016 年增长 22.71%。

上述经营业绩的实现主要原因有：

1、国家对半导体行业的政策支持

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家战略性的、基础性和先导性产业。国家相继出台了若干产业政策，大力支持集成电路产业发展。2014 年 6 月，国务院印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》

(简称“《纲要》”),将提升先进封装测试业发展水平列为主要任务和发展重点之一,指出要大力推动国内封装测试企业兼并重组,提高产业集中度。适应集成电路设计与制造工艺节点的演进升级需求,开展芯片级封装(CSP)、圆片级封装(WLP)、硅通孔(TSV)、三维封装等先进封装和测试技术的开发及产业化。《纲要》同时提出设立国家产业投资基金,重点支持集成电路等产业发展,促进工业转型升级。2016年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布,提出大力推进先进半导体……等新兴前沿领域创新和产业化,形成一批新增长点。

2、国内半导体行业的快速发展

我国是半导体终端需求的主要市场,在《国家集成电路产业发展推进纲要》进一步落实和国家集成电路产业投资基金的推动下,我国半导体市场已成为全球增长引擎,销售收入增长速度远高于全球增速,保持着快速发展。根据中国半导体行业协会统计,自2009年以来我国集成电路市场保持高速增长,至2017年,我国集成电路市场销售规模从1,109亿元增长至5,411.34亿元,期间的年均复合增长率达到21.90%。通信和消费电子是我国集成电路最主要的应用市场。

从产业链结构看,2017年我国集成电路产业链各环节均呈现增长态势。其中,设计业继续保持高速增长,销售额为2,073.5亿元,同比增长26.1%;制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动,2017年依然快速增长,同比增长28.5%,销售额1,448.1亿元;封装测试业销售额1,889.7亿元,同比增长20.8%。(数据来源:中国半导体行业协会)。IC设计业的快速发展带动了国内芯片代工与封装测试需求快速增长。

3、原长电各经营主体业务发展情况良好

2017年,原长电下属各经营主体主营业务发展情况良好。其中,长电先进新导入客户开始量产,订单需求增加,2017年度实现净利润32,193.95万元,同比增长76.78%;长电滁州通过技术改造及挖潜增效,2017年度实现净利润21,816.81万元,同比增长38.21%;长电科技母公司实现营业收入700,669.31万元,净利润22,570.54万元,分别同比增长13.66%和95.84%;长电宿迁通过产品结构进一步调整和提高产能利用率,2017年实现营业收入84,487.02万元,比

上年同期增加 24.70%，实现净利润 4,312.03 万元，同比已实现扭亏为盈。

综上，原长电业绩增长趋势具有合理性。

二、原长电与星科金朋业绩变化差异的原因

除星科金朋工厂搬迁、个别大客户订单下滑等因素外，原长电与星科金朋业绩变化差异的主要原因如下：

1、产品结构存在差异

目前，星科金朋的产品结构仍偏重于手机及移动通讯领域，2017 年及 2016 年，该领域的营业收入占星科金朋全年营业收入比重分别为 63.8%和 75.8%。原长电的产品应用领域包括计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、工业自动化控制、电源管理、汽车电子等领域，产品结构较为均衡。由于手机及移动通讯领域周期性及季节性波动较大且近年来增长趋缓，因此星科金朋的业绩受此影响与原长电业绩出现一定差异。

2、下游客户群体及客户结构存在差异

星科金朋与原长电面向的市场不同，其客户群体及客户结构也存在一定差异。目前，星科金朋的客户均为国际顶尖的 IC 设计公司，欧美地区客户占比较大且客户相对更为集中，2017 年星科金朋来自美国地区的收入占比为 56.67%，来自亚洲地区的收入占比 29.75%；原长电欧美客户占比较星科金朋相对较低，中国国内及亚洲地区客户占比较星科金朋客户相对更大，2017 年原长电来自美国地区的收入占比为 57.39%，来自亚洲地区的收入占比 42.40%。目前，我国集成电路行业仍处于高速发展期，而欧美地区集成电路行业发展速度相对较为平缓，由此导致原长电的主营业务发展速度高于星科金朋。

3、成本存在差异

目前，星科金朋主要在新加坡、韩国及中国开展生产经营活动，且其总部位于新加坡，而新加坡及韩国的人工成本高于国内，从而导致星科金朋的人工成本占比较高。同时，星科金朋主要从事先进封装测试业务，其相关固定资产相对较大，折旧等固定成本较高，而产能利用率低，直接导致毛利较低。

三、为解决分部间发展不平衡采取的措施

1、加大对星科金朋的整合力度，尽快恢复其盈利能力

2015年8月要约收购完成以来，公司对星科金朋管理、销售、采购、人力资源等方面进行了全面整合，并采取了针对性措施改善其业绩。关于公司对星科金朋的整合措施及效果，请参见本回复问题1之“三、拟采取的改善经营的应对措施及后续相关业务的发展战略安排，星科金朋集团利润补偿协议完成的可能性”及本回复问题2。

2、产能资源统筹利用，客户资源共享

公司抓住中国市场高速发展的机遇，利用公司在中国市场的影响力，共享客户资源；同时统筹利用全球各工厂产能资源，进行产销衔接，提高星科金朋产能利用率，满足客户需求，平衡各板块间的发展。

3、优化负债结构

公司将制定债务优化方案，降低星科金朋资产负债率和财务费用。同时，产业基金、芯电半导体（最终股东为中芯国际）已经成为公司主要股东，将支持优化星科金朋财务状况。2017年公司利用直接融资偿还了1.2亿美元并购贷款，并帮助星科金朋偿还了7,500万美元优先票据。

4、加强文化融合

收购星科金朋后，公司始终倡导“同一个企业、同一个团队、同一个梦想”的企业文化，弘扬和睦卓越的大家庭式企业文化，持续推进和谐文化和执行力文化。目前，公司围绕长电科技集团的凝聚力已经形成，企业文化、价值观和发展目标得到认同。

综上，公司未来将继续加强对星科金朋的整合力度，实现各版块间的均衡发展。

5、盈利严重依赖非经常性损益。公司 2015、2016、2017 年扣除非经常性损益的归母净利润分别为 584.76 万元、-2.06 亿元、-2.63 亿元，非经常性损益分别为 4614.99 万元、3.12 亿元、6.06 亿元，公司近两年均通过非经常性损益避免亏损。请说明：（1）本期新增其他符合非经常性损益定义的损益项目 1.11 亿元，请补充其具体明细，发生原因以及确认依据；（2）2016 年、2017 年政府补助分别为 2.07 亿元、3.51 亿元，均高于扣非后净利润，公司严重依赖政府补助，请结合相关项目批文和政府补助类型等，说明相关补助的可持续性，是否存在政府补助不足以弥补亏损的可能；（3）其中非流动资产处置损益金额为 1.27 亿元，请补充披露具体交易背景、金额和资产明细等。

回复说明：

一、本期新增其他符合非经常性损益定义的损益项目 1.11 亿元，请补充其具体明细，发生原因以及确认依据

本期新增其他符合非经常性损益定义的损益项目 1.11 亿元系本期预计负债相关事项有效解决而转回的损益影响。

2015 年 8 月长电科技收购星科金朋前，星科金朋针对其子公司星科金朋（上海）有限公司（SCC）和 STATS ChipPAC Korea Ltd.（SCK）预提的历史期间通过 STATS ChipPAC (BVI) Ltd.进一步销售给第三方客户相关的转让定价税务风险。长电科技收购星科金朋之前，星科金朋集团选用交易净利润法作为转让定价方法评估并计提了相关转让定价税务风险。

随着近年来经济合作与发展组织（OECD）“税基侵蚀与利润转移”（BEPS）行动计划在全球持续推进，中国国家税务总局分别于 2016 年 6 月 29 日和 2017 年 3 月 17 日发布了《关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》（2016 年第 42 号公告）和《特别纳税调查调整及相互协商程序管理办法》（2017 年第 6 号公告），上述最新颁布的转让定价法规强调价值链分析方法的重要性；因此，SCC 聘请了专业税务顾问协助其与主管税务机关进行沟通和协商，并根据中国国家税务总局 2017 年第 6 号公告规定的协商程序，在经过多次材料递交、解释说明并与上海市青浦区国家税务局的若干次协商后，公司就转让定价自行调整方案与上海市青浦区国家税务局达成基本一致意见。SCC 于 2017 年 7 月 31 日，

就 2006-2015 年度转让定价事项进行自行调整并补缴企业所得税及其利息共计人民币 38,249,726.32 元，该税款及利息已于当天缴纳入库并收到《税收完税证明》，同时转回了原计提的相关预计负债的超出部分。SCK 亦聘请了专业税务顾问协助其与韩国主管税务机关进行沟通和协商，韩国主管税务机关于 2017 年中进行了转让定价调查并对韩国星科金朋 2013-2015 年度转让定价事项作出了转让定价调整，于 2017 年 9 月支付了转移定价相关的税金约 163 万美金（折合人民币 1,082 万元），同时转回了原计提的相关预计负债的超出部分。

二、结合相关项目批文和政府补助类型等，说明相关补助的可持续性，是否存在政府补助不足以弥补亏损的可能

1、政府补助基本情况

2017 年及 2016 年，公司计入当期损益的政府补助情况如下：

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	主要批文
计入其他收益的政府补助金额	28,774.63	-	ZX02[2014]018 号，ZX02(2012)008 号，苏科计发[2014]192 号等
计入营业外收入的政府补助金额	6,331.50	20,675.01	澄高经发[2017]1 号，沪科[2015]576 号，滁发改高 技[2014]398 号等
合计	35,076.13	20,675.01	

注：公司自 2017 年起采用财政部新颁布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，将与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减成本费用。

关于公司每年的政府补助明细，请参见公司 2017 年及 2016 年年度审计报告财务报表附注。关于公司政府补助的具体情况，公司已履行相应信息披露义务，请参见公司相关公告文件。

2、相关补助的可持续性，公司对政府补助不存在重大依赖

(1) 相关项目的可持续性

公司收到的政府补助中，与日常活动相关的政府补助主要为相关科研项目收到的补助资金，公司作为国内集成电路封装测试行业的龙头企业，每年承担大量的科研任务，预计未来仍将承担相当数量的科研项目，该等政府补助具有不确定性。

与此同时，公司收到的与日常活动无关的政府补助项目主要系公司因收购、引进人才、技术创新等特定事项收到的政府奖励及补助，该等政府补助不具有可持续性，但其占比较小，对公司的生产经营及业绩情况不具有重大影响。

(2) 公司在承担科研项目的同时需要投入自有资金

在承接科研项目后，于项目执行过程中，公司需要按照一定比例（具体比例视项目情况及款项性质而定）配套投入资金，并将产生相应的研发支出。与此同时，公司收到的上述政府补助也专款专用于相应项目。

2017 年及 2016 年，公司政府补助金额及研发支出金额如下：

单位：万元

年份	2017 年	2016 年
公司收到的政府补助金额	35,076.13	20,675.01
公司研发支出	78,436.17	63,788.32

从上表的对比可以看出，公司报告期内的研发支出高于政府补助金额，即若公司不承担上述科研项目，一方面公司收到的与日常活动相关的政府补助金额将大幅降低，另一方面公司相应项目研发支出也将减少。因此，公司政府补助金额较高主要系公司为积极开展封装测试领域的技术研发并承接多种科研项目所致。通过接受上述政府补助，公司实施了多项技术含量高、产业带动能力强的项目，开发出了一系列对行业有明显意义的技术与产品。

从 2018 年第一季度情况看，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,435.17 万元，比上年同期减亏了 4,261.81 万元，减亏幅度 55.37%。

综上，公司收到的政府补助具有不确定性，2018 年第一季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润已经大幅减亏，逐步向好。

三、非流动资产处置损益金额为 1.27 亿元，请补充披露具体交易背景、金额和资产明细等

非流动资产处置损益包括处置长期股权投资产生的投资收益 0.87 亿元和固定资产处置收益 0.40 亿元。处置长期股权投资产生的投资收益来自公司 2017 年转让国富瑞数据系统有限公司 19.99%的股权，转让价格为人民币 14,000 万元，

确认出售国富瑞数据系统有限公司股权的投资收益人民币 8,685.78 万元。固定资产处置损益主要来自于星科金朋的固定资产处置。

6、年报披露，星科金朋在重组中剥离了原台湾子公司并与其签署了《技术服务协议》，约定最低采购金额并记入衍生金融负债。2017 年期末衍生金融负债余额为 1.05 亿元，较 2016 年的 4.06 亿元减少 74.13%。请公司（1）补充上述协议的主要条款，包括时间、金额、采购商品情况等，合同的执行情况及剩余未来义务；（2）相关会计政策、上述协议安排记入衍生金融负债的会计处理依据、以及上述变化情况和原因，并请会计师发表意见。

回复说明：

一、上述协议的主要条款，包括时间、金额、采购商品情况等，合同的执行情况及剩余未来义务

1、《技术服务协议》签署过程及主要条款

由于台湾地区对于大陆企业投资台湾半导体相关行业企业存在一定的政策限制，大陆企业不得对台湾半导体封装及测试企业具有控制能力，公司要约收购星科金朋的过程中将其台湾子公司 SCT1、SCT3 通过重组进行了剥离。

SCT1、SCT3 主要为星科金朋韩国子公司 SCK 的倒装（FC）业务提供凸块中段制造（Bumping）及测试服务，重组剥离后星科金朋韩国子公司 SCK 将成为 SCT1、SCT3 客户，向 SCT1、SCT3 采购服务和产品，双方构成业务合作关系。

根据公司要约收购方案的约定，同时为了：（1）SCT3 归还欠星科金朋的 1.27 亿美元股东借款，（2）保证重组剥离后星科金朋与台湾子公司 SCT1、SCT3 三方的业务和正常经营不受影响，（3）发挥 SCT1、SCT3 的区位优势帮助星科金朋承接台湾客户订单，2015 年 8 月，星科金朋与 SCT1、SCT3 签署了《技术服务协议》。

《技术服务协议》约定协议期限内星科金朋有权按约定价格向 SCT1、SCT3

下达采购订单；SCT1、SCT3 预留产能给星科金朋，以及时提供服务。协议初始期限为签署之日起的 5 个合同年度（每一合同年度为当年 8 月 5 日起的连续 12 个月）。

《技术服务协议》同时约定，星科金朋承诺并同意 SCT1、SCT3 符合条件的收入在任何一个合同年度中均不得低于在该合同年度中的最低采购金额（Minimum Spend），具体如下：

单位：千美元

年份	期限	最低采购金额
第 1 年	2015 年 8 月 5 日-2016 年 8 月 4 日	95,000
第 2 年	2016 年 8 月 5 日-2017 年 8 月 4 日	80,800
第 3 年	2017 年 8 月 5 日-2018 年 8 月 4 日	75,100
第 4 年	2018 年 8 月 5 日-2019 年 8 月 4 日	63,200
第 5 年	2019 年 8 月 5 日-2020 年 8 月 4 日	51,400

协议期限内，若每一合同年度 SCT1、SCT3 取得的符合条件收入（Eligible Revenue）低于最低采购金额，SCT1、SCT3 可依据协议约定程序向星科金朋主张差额补偿（Reconciliation Payment）；

星科金朋可以选择将该合同年度不超过最低采购金额 5% 的部分（Maximum Deferred Revenue）递延到下一合同年度，不在该合同年度结束后补偿；星科金朋每年只能行使递延权利一次，且该递延部分不得于次年度再递延，最后一合同年度不得行使递延权利。

基于星科金朋与 SCT1、SCT3 原有业务量约 1.1 亿美元/年，且 SCT1、SCT3 正常经营需依赖于星科金朋下达的订单，要约收购谈判时作为要约生效条款之一的《技术服务协议》约定了前述的 5 个合同年度的最低采购金额。

2015 年第三季度开始，个别大客户对星科金朋韩国子公司 SCK 订单突然下降，导致 SCK 对 SCT1、SCT3 采购量也大幅下滑，2015 年 8-12 月星科金朋向 SCT1、SCT3 采购金额仅为 1,400 余万美元。

考虑到订单回补需要时间，公司预计未来将根据《技术服务协议》的约定做出补偿，并聘请专业机构对补偿金额的公允价值进行了评估，星科金朋于 2015 年末计提了约 8,600 万美元的“最低采购承诺”拨备，以反映补偿风险的最佳估

计。

2、合同的执行情况及剩余未来义务

鉴于2015年8-12月星科金朋向SCT1、SCT3采购金额极低的情况，一方面公司计提了“最低采购承诺”拨备，另一方面公司将《技术服务协议》履行作为重大项目管理，明确责任人和管理团队解决对SCT1、SCT3履约问题。

通过导入新客户与新产品等措施，2016年以来星科金朋对SCT1、SCT3订单量开始逐步上升，2016年四个季度订单金额分别超过1,300、1,900、1,900、1,800万美元，合计金额超过7,000万美元，加上协议约定的最低采购额逐年递减，预计协议期间后续年度补偿额将加速减少。

2015年8月5日-2016年8月4日的第一合同年度，星科金朋对SCT1、SCT3的采购金额合计约5,300万美元，与第一合同年度最低采购金额差额达4,200万美元。2017年1月，经协商双方达成一致，星科金朋最终向SCT1、SCT3补偿了3,019.66万美元，此部分金额冲减了最低采购承诺拨备的余额。

2016年8月5日-2017年8月4日的第二合同年度，星科金朋对SCT1、SCT3的采购金额合计约6,082万美元，与第二合同年度最低采购金额差额约2,000万美元。2017年11月，经协商双方达成一致，星科金朋向SCT1、SCT3补偿约1,570万美元，此部分金额冲减了最低采购承诺拨备的余额。

结合上述订单采购实际情况以及星科金朋向SCT1、SCT3支付的补偿金情况，基于星科金朋对SCT1、SCT3的采购金额逐年上升、第三至第五年度最低采购承诺金额逐年下降以及自第三年度起星科金朋将以市场价格向SCT1、SCT3进行采购等事实，公司认为对SCT1、SCT3预提的最低采购承诺风险已逐步释放，剩余未来补偿义务较低。

二、请公司补充说明相关会计政策、上述协议安排记入衍生金融负债的会计处理依据、以及上述变化情况和原因

1、相关会计政策

与最低采购承诺形成的衍生金融负债相关的会计政策如下，并已披露于财

务报表“附注三、8”，具体如下：

“衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。”

2、记入衍生金融负债的会计处理依据、以及上述变化情况和原因

星科金朋根据《技术服务协议》需要补偿的金额为星科金朋保证的最低采购金额与 SCT1、SCT3 收入之差额，随 SCT1、SCT3 收入的变动而变动，该合同无初始净投资，并在未来由星科金朋采用现金结算。根据企业会计准则第 22 号《金融工具确认和计量》，公司将其确认为衍生金融工具，并以公允价值计量且其变动计入损益。

于 2017 年度，星科金朋已支付第一合同年补偿金额即 2015 年 8 月至 2016 年 7 月的补偿金额及部分第二合同年补偿金额即 2016 年 8 月至 2017 年 7 月的补偿金额，合计支付补偿款项 3,720 万美元。同时基于星科金朋对 SCT1、SCT3 的采购金额逐年上升、第三至第五合同年度最低采购承诺金额逐年下降，以及自

第三合同年度起星科金朋将以市场价格向 SCT1、SCT3 进行采购等事实，公司预计对 SCT1、SCT3 第三至第五合同年度在《技术服务协议》下的补偿金额亦将显著减少。2017 年末，星科金朋聘请专业机构再次对最低采购承诺的公允价值进行了评估。鉴于上述因素，2017 年 12 月 31 日最低采购承诺公允价值为 1.05 亿元，较 2016 年 12 月 31 日的 4.06 亿元减少 74.13%。

三、年审会计师意见

会计师安永意见：在对长电科技 2017 年度合并财务报表进行审计过程中，我们按照中国注册会计师审计准则对上述衍生金融负债执行了审计程序，我们认为长电科技于 2017 年 12 月 31 日对衍生金融负债的会计处理在所有重大方面符合企业会计准则的要求。

7、年报披露，公司报告期内提高了管理效率和执行力。但管理费用本期发生额 20.08 亿元，较上期发生额 15.95 亿元同比增长 25.89%，请公司补充披露：（1）管理费用中职工薪酬本期发生额 7.58 亿元，同比增长 36.82%，请说明在员工人数没有显著增长的情况下职工薪酬大幅增加的原因；（2）管理费用中其他类科目，本期发生额 1.12 亿元，请披露其具体明细。

回复说明：

一、管理费用中职工薪酬本期发生额 7.58 亿元，同比增长 36.82%，请说明在员工人数没有显著增长的情况下职工薪酬大幅增加的原因

2017 年公司管理费用中职工薪酬发生额较 2016 年增加了 2.04 亿元，其中主要是：（1）本期 SCC 因搬迁发生人员遣散及安置费约人民币 1.08 亿元，（2）因本期公司销售情况良好，规模扩大，相关管理员工资和奖金等随着企业效益增加而增长了约人民币 0.96 亿元。

二、管理费用中其他类科目，本期发生额 1.12 亿元，请披露其具体明细

管理费用中“其他类科目”本期发生额 1.12 亿的明细如下：

性质	金额（人民币万元）	备注
----	-----------	----

性质	金额（人民币万元）	备注
搬厂费	4,490.67	1
服务费	3,424.10	2
物业绿化费	1,858.71	
租赁及安保费	985.83	
其他	486.43	3
合计	11,245.74	

注：1、搬厂费系 SCC 搬迁费及 SCK 第二工厂搬迁费。

2、服务费主要包括技术服务费、顾问费和网络软件维护费等。

3、其他主要包括招聘费、保养检测费等。

8、年报显示，报告期内公司投入研发费用共计 7.84 亿元，同比增长 23%，且全部费用化。研发人员占总人数 24.56%。请按照《格式准则第 2 号》第二十六条，补充披露：（1）公司具体研发项目名称、应用领域、项目进展、报告期内研发投入情况；（2）近三年来研发费用的明细及研发投入的主要考虑；（3）研发费用资本化和费用化的依据及近三年全部费用化的原因；（4）近三年来公司研发投入所取得的成果及其对公司本期和未来经营业绩的影响；（5）研发人员相关信息，包括但不限于人数、教育水平、过往研发经验、人员平均工资等。

回复说明：

一、公司具体研发项目名称、应用领域、项目进展、报告期内研发投入情况

公司作为国内集成电路封装测试行业的龙头企业，于报告期内研发项目众多，其中报告期内投入金额较大的项目主要有：

单位：万元

项目名称	项目进展	2017 年研发投入情况
项目一	已完成	6,676.27
项目二	进行中	4,742.66
项目三	进行中	3,749.43
项目四	进行中	3,431.58
项目五	进行中	3,266.34
项目六	进行中	2,384.00
项目七	进行中	2,063.37

项目名称	项目进展	2017 年研发投入情况
项目八	进行中	2,009.58
项目九	已完成	1,985.06
项目十	已完成	1,953.30
合计		32,261.58

上述项目集中于集成电路封装及测试领域，主要应用于通讯、汽车电子、智能移动终端等下游产品。2017 年公司持续加强先进封装测试技术的领先优势，并通过实施各种先进研发项目来实现产品组合的多元化。例如，用于 5G /毫米波，网络，存储，高性能计算（HPC），MEMS /传感器和汽车应用等的项目包括采用超出 10nm 先进硅节点技术的高端倒装产品，高密度（HD）扇出型晶圆级封装 FOWLP（eWLB）的批量生产，先进的 ECP 技术，大功率产品和高度集成的 3D SiP 模块。为满足客户的需求并为新兴应用和市场做好准备，公司将继续寻求开发旗舰产品，例如 SiP，扇出型晶圆级封装 FOWLP（eWLB，ECP）和先进倒装芯片（Flip Chip）/混合封装。

二、近三年来研发费用的明细及研发投入的主要考虑

2015 年、2016 年及 2017 年，公司研发费用的明细如下：

项目	2015 年	2016 年	2017 年
人员员工费用	14,350.57	23,474.96	30,662.05
直接投入费用	23,730.59	22,999.85	27,843.03
折旧与长期待摊费用	8,837.56	11,510.37	14,132.83
无形资产摊销费用	640.87	1,827.72	1,957.40
委托外部研究并开发费用	193.85	460.50	461.47
其他费用	1,760.15	3,514.92	3,379.40
合计	49,513.59	63,788.32	78,436.17

近三年产品研发方向主要是按照公司整体发展规划要求执行。公司在制定研发计划时，坚持制定出和国际大公司接轨、与国际领先同行同步的技术发展路线图，与国际一流竞争对手并行发展、超越发展；跟上一流客户技术发展的步伐，加强创新，不断提升自身的研发能力和产品的技术水平；同时加强公司的知识产权保护。

三、研发费用资本化和费用化的依据及近三年全部费用化的原因

根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》：

“第七条 企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

第八条 企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

第九条 企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

（一）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（三）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

（四）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。”

公司研发的项目主要系针对市场和客户需求开展新一代半导体封测的新技术的研究。由于近三年的研发成果为公司带来经济利益具有一定的不确定性，不满足会计准则对开发支出资本化的有关规定，因此公司将近三年所有的研发支出全部计入当期费用。

四、近三年来公司研发投入所取得的成果及其对公司本期和未来经营业绩的影响

1、公司近三年来研发投入取得的成果

近三年来，公司通过持续的科研投入和技术创新，取得了丰硕的成果。截至

2017年12月31日，公司已获得专利3,504件，其中发明专利2,743件（含在美国获得的专利1,758件），基本覆盖了中高端封测领域。公司目前在高端封装技术领域已经与国际领先企业并行发展，公司掌握并实现大规模生产的先进封装技术包括Fan-out eWLB、WLCSP、Bumping、SiP等。在先进封装晶圆份额方面，公司以7.8%位列全球第三。

公司在国内及新加坡拥有三大研发中心，国内的研发中心领域覆盖功率类模块、MIS封装、SiP封装以及企业内部运营系统研发等，新加坡的两个研发中心领域覆盖FOWLP（eWLB）、SiP及FC等。目前上述研发中心已有多款产品进入量产或取得客户认证。

2、上述研发成果对公司本年及未来业绩的影响

公司近年来的研发成果集中在集成电路封装与测试领域，上述研发成果使得公司在中高端封装测试尤其是先进封装领域处于领先地位，同时也有多款产品成功导入并实现量产，为公司的营业收入增长提供了有力的支撑。未来，公司将继续进行技术创新，持续对技术研发进行投入，提升公司产品价值，增强市场竞争能力。

五、研发人员相关信息

截至2017年底，公司共有研发人员5,726人，教育水平情况如下：

学历	人数
博士	12
硕士	227
本科	2,061
大专	2,573
其他	853
合计	5,726

其中，主要核心技术人员经历如下：

姓名	经历
赖志明	赖志明先生 2003 年组建长电先进并担任总经理，全面负责中道相关先进封装技术研发及产业化，已申请专利超过一百余项，范围覆盖了传统封装和先进封装领域，大部分专利已被业界采用并规模化生产
梁新夫	拥有非常丰富的半导体先进封装技术的研发和管理经验。在行业国际会议和国

	际核心学术期刊上发表近 20 篇高水平论文，拥有国际专利 10 余项，尤其在 SiP 多芯片微模封装（MCM-L）的开发中创造了多次世界首创
Han Byung Joon（韩丙濬）	哥伦比亚大学博士，曾服务于亚南半导体、AT&T 贝尔实验室和 IBM，曾兼任国际电子生产商联盟和新加坡知识产权局理事会成员，光星电子香港有限公司、台星科和韩国 Simmtech 董事
SHIM IL KWON（沈一权）	在韩国科学技术院完成了材料科学与工程博士课程。历任星科金朋副总裁兼公司技术创新负责人和研发负责人，在 Amkor 韩国和美国的先进产品研发部担任过不同的产品研发和管理工作。沈一权先生拥有超过 170 项被美国专利和商标局授予的专利

9、年报披露，本年度公司前五名客户销售额 66.43 亿元，占年度销售总额的 27.85%。请补充披露：（1）前五名客户的名称、金额及对应项目或业务情况；（2）上述主要客户是否相比以前年度发生较大变化；（3）是否存在对主要客户依赖的风险及应对措施。

回复说明：

一、前五名客户的名称、金额及对应项目或业务情况

2017 年：

客户名	金额（人民币亿元）
客户 A	16.61
客户 B	12.84
客户 C	12.58
客户 D	12.43
客户 E	11.97
合计	66.43

2016 年：

客户名	金额（人民币亿元）
客户 E	13.33
客户 F	10.66
客户 B	10.33
客户 A	9.89
客户 C	6.68
合计	50.89

上述客户主要产品应用于通讯、移动智能终端、消费电子等领域。公司与上述客户签署有保密协议，根据保密协议相关条款，在未经其同意的情况下，公司如披露其相关信息，将承担违约责任；同时，公司与前五大客户之间的合作涉及商业秘密，若公开披露，可能会给公司带来经济损失，损害全体股东利益，故公司根据《公司信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》相关条款，豁免披露前五大客户相关信息。

二、上述主要客户是否相比以前年度发生较大变化

本年主要客户相比 2016 年未发生重大变化。

三、是否存在对主要客户依赖的风险及应对措施

公司的前五名客户均为半导体业界的知名客户，从公司整体前五名客户的交易金额及占比情况看，单一客户的占比均不超过 20%，不存在对主要客户的严重依赖风险。

10、年报披露，公司报告期内分季度实现营业收入分别为 50.25 亿元、52.97 亿元、65.38 亿元、69.96 亿元，实现扣非后归母净利润分别为-7696.98.13 万元、-1.03 亿元、-1.73 亿元、-9067.93 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 26.83 亿元、11.90 亿元、11.60 亿元、10.39 亿元。请公司补充披露：（1）结合公司分季度经营数据及现金流情况，说明公司业绩季度波动的原因及合理性，本年主营业务季度变化趋势与以前年度不一致的原因及合理性；（2）经营活动产生的现金流量四个季度波动较大且与净利润差异较大的原因及合理性。

回复说明：

一、公司分季度经营数据情况

1、公司 2017 年业绩季度波动的原因及合理性

2017 年，公司分季度主要经营数据如下：

单位：万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	502,458.43	529,729.68	653,792.52	699,570.61
毛利	49,301.71	54,266.26	65,269.06	110,612.94
期间费用	71,741.96	74,116.90	75,792.19	101,579.66
利润总额	-6,714.91	-8,606.94	5,590.28	12,128.57
净利润	-10,464.95	-8,832.01	8,036.28	18,614.66
归属于上市公司股东的净利润	3,829.77	5,069.46	7,619.25	17,816.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,696.98	-10,337.13	-17,320.28	9,067.93

营业收入及营业毛利方面，半导体行业具有一定的季节性与周期性，每年上半年为半导体行业的传统淡季，因此 2017 年前两季度合并层面的营业收入、毛利及期间费用数据低于 2017 年度下半年，这与行业的季节性因素一致。

就归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“扣非后归母净利润”）而言，第二季度相比第一季度，由于公司自 2017 年 6 月起开始对星科金朋合并比例上升为 100%，星科金朋仍处于亏损中，导致扣非后归母净利润有一定下降。第三季度相比第二季度，公司营业收入及营业毛利较前一季度有较大程度上升，但由于公司于自 2017 年 6 月开始对星科金朋持股比例从 39.39% 上升至 100%，因此 2017 年第三季度扣非后归母净利润有一定下降。随着星科金朋 2017 年第四季度业绩好转及原长电业务的持续发展，第四季度扣非后归母净利润大幅上升。

2017 年第二季度和第三季度，公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）逐步上升主要受到非经常性损益的影响。其中第二季度公司因出售国富瑞股权确认 8,685.78 万元投资收益；第三季度公司因预计负债转回及递延收益转入其他收益确认较大金额的非经常性损益。2017 年第四季度，随着公司主营业务好转，公司的利润总额及净利润也同步上升。

关于公司分季度经营活动现金流的变化情况分析，请参见本题“二、经营活动产生的现金流量波动较大且与净利润差异较大的原因和合理性”。

2、公司 2017 年度主营业务季度变化趋势与 2016 年度不一致的原因及合理性

2016 年及 2017 年各季度，公司主营业务变化趋势如下：

单位：万元

项目		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2017 年	502,458.43	529,729.68	653,792.52	699,570.61
	2016 年	350,649.64	400,496.22	577,149.20	587,157.71
归属于上市公司 股东的净利润	2017 年	3,829.77	5,069.46	7,619.25	17,816.20
	2016 年	2,815.45	-1,744.14	4,900.06	4,662.08
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润	2017 年	-7,696.98	-10,337.13	-17,320.28	9,067.93
	2016 年	-3,189.16	-14,187.02	685.29	-3,897.41
销售商品、提供劳 务收到的现金	2017 年	524,396.09	525,411.45	606,669.33	852,982.81
	2016 年	369,287.48	355,703.26	540,455.03	690,883.88
经营活动产生的 现金流量净额	2017 年	26,830.11	118,981.86	116,031.93	103,880.63
	2016 年	19,115.77	62,399.52	67,128.22	118,284.81

公司 2016 年及 2017 年的分季度营业收入及销售商品、提供劳务收到的现金变动趋势基本一致。扣非后归母净利润方面，2016 年第二季度由于 JSCK 开始试生产产生较大亏损且原长电经营业绩有一定下滑，星科金朋虽然业绩有所改善但是受少数股东损益的影响，2016 年第二季度该项指标较 2016 年第一季度出现较大程度的下降。2016 年第三季度与 2017 年第三季度变化趋势的差异主要系 2017 年第三季度开始公司对星科金朋拥有 100% 的股权所致。2016 年第四季度与 2017 年第四季度变化趋势的差异主要系 JSCK 于 2016 年第四季度产生较大幅度亏损，业绩比 2016 年第三季度有所下降。

归母净利润变化趋势的差异主要因为各季度非经常性损益构成不同，且各季度扣非后归母净利润变化趋势存在差异所致。2016 年及 2017 年各季度非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
非流动资产处置损益	2017	320.90	9,010.93	561.10	2,820.09
	2016	-161.06	-458.92	-36.74	363.44
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相	2017	9,467.78	4,501.87	19,328.36	1,778.13

项目		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2016	6,601.65	6,877.48	1,903.91	5,291.97
委托他人投资或管理资产的损益	2017	-	-	-	154.13
	2016	178.16	129.66	182.71	72.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2017	6,893.20	-	-	-85.71
	2016	-	11,150.65	4,027.14	233.94
单独进行减值测试的应收款项减值	2017	-	-	-	2,012.50
	2016	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2017	26.86	224.38	-42.71	-830.59
	2016	926.40	-747.53	361.13	-383.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2017	-	-	11,358.77	-284.45
	2016	-	-	-	-
少数股东权益影响额(税后)	2017	-2,653.12	2,650.33	-4,754.00	279.37
	2016	-393.87	-5,107.65	-2,042.91	3,232.25
所得税影响额	2017	-2,528.87	-980.91	-1,512.00	2,904.81
	2016	-1,146.68	599.19	-180.47	-250.77
合计	2017	11,526.75	15,406.59	24,939.53	8,748.27
	2016	6,004.60	12,442.87	4,214.77	8,559.49

经营活动产生的现金流量净额方面,2016年度与2017年度趋势基本一致,其差异主要源于各季度经营性应收应付项目变动的差异。

综上,公司2017年度各季度业绩波动及2016年度与2017年度主营业务变动趋势存在差异具有合理性。

二、经营活动产生的现金流量波动较大且与净利润差异较大的原因和合理性

2017年各季度公司净利润与经营活动产生的现金流量净额关系如下:

将净利润调节为经营活动现金流量:	2017年 第一季度	2017年 第二季度	2017年 第三季度	2017年 第四季度
净利润	-10,464.95	-8,832.01	8,036.28	18,614.66
加:资产减值准备	766.02	-6.83	-571.10	2,081.29
固定资产折旧、油气资产折耗、	68,941.76	72,224.64	80,943.19	80,145.40

将净利润调节为经营活动现金流量：	2017年 第一季度	2017年 第二季度	2017年 第三季度	2017年 第四季度
生产性生物资产折旧				
无形资产摊销	1,573.96	1,829.33	4,674.00	5,883.85
投资性房地产折旧及摊销	57.00	38.57	134.43	92.71
长期待摊费用摊销	93.48	95.15	187.55	261.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-179.70	-715.46	-312.00	-2,820.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,893.20	-	-	85.71
财务费用（收益以“-”号填列）	26,811.70	26,486.82	24,352.74	18,059.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-113.00	-8,353.74	92.09	-130.90
递延收益摊销	1,244.11	2,576.23	-18,965.64	-12,844.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	855.29	-337.58	126.61	-2,083.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	812.02	-202.83	0.52	733.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,176.91	-17,005.95	-37,936.97	-3,936.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,965.61	13,545.25	-57,792.27	-1,099.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,816.90	37,640.25	113,062.51	838.91
其他		-		
经营活动产生的现金流量净额	26,830.11	118,981.86	116,031.93	103,880.63

从上表可以看出，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大主要系公司处于重资产行业，折旧、摊销金额较大，公司财务费用较高，同时经营性应收应付项目的波动共同导致公司各季度经营活动产生的现金流量净额均高于净利润。

公司各季度经营活动产生的现金流量波动较大主要系公司各季度存货、经营性应收应付项目的变动差异所致，由于公司所处集成电路行业具有一定的季节性，同时公司与客户及供应商的账款结算周期也存在一定差异，因此公司各季度经营性现金流量出现一定波动与行业情况一致。同行业可比上市 2017 年分季度经营性活动产生的现金流量净额情况如下：

单位：万元

公司	2017年 第一季度	2017年 第二季度	2017年 第三季度	2017年 第四季度
通富微电	19,824.58	13,233.28	42,769.63	25,141.50
华天科技	16,121.60	32,569.65	11,609.80	30,052.55
晶方科技	7,709	3,866.53	4,598.13	7,280.15
长电科技	26,830.11	118,981.86	116,031.93	103,880.63

11、年报显示，其他应付款中期末余额合计为2.3亿元，其中员工业务风险金为3590.66万元，其他科目余额为5706.03万元。请补充披露：（1）员工业务风险金的具体形成原因、应付对象、用途等详细情况；（2）其他科目占其他应付款合计的24.78%，请具体披露其明细信息，包括但不限于形成原因、对象、用途等详细情况。

回复说明：

一、员工业务风险金的详细情况

员工业务风险金主要系为保证业务人员对口客户的销售应收款项能及时收回，公司提取业务人员当年部分绩效奖励作为业务回款风险金。

二、其他科目明细信息

本期其他应付款-其他科目明细如下：

项目	金额（人民币万元）
运费	1,822.14
动力费及办公费	914.24
修理费及保养费	684.80
咨询顾问费	681.58
其他	1,603.27
合计	5,706.03

其中其他主要包括应付体检费、应付清洁费及应付安保费等。

12、报告期末应付债券合计 27.21 亿元，其中，星科金朋于 2015 年 8 月向其原股东 STSPL 发售了一项年利率为 4%的永续证券，共计 2 亿美元，形成一年内到期的永续证券 13.07 亿元，公司对其偿还出具担保承诺。请详细披露该永续证券的赎回条款、担保承诺情况、公司偿债能力及相关债务事项，并结合公司货币资金和信贷状况等分析对上市公司经营的影响。

回复说明：

一、该永续证券的赎回条款、担保承诺情况、公司偿债能力及相关债务事项

2015 年 8 月，由于要约收购导致星科金朋控股股东变化，星科金朋进行了债务重组并替换星科金朋原有部分债务，星科金朋向原所有股东配售规模为 2 亿美元永续证券（perpetual securities），淡马锡及其他小股东共计认购星科金朋发行的 2 亿美元的永续证券。具体情况如下：

1、赎回条款

该永续证券无固定赎回日期，星科金朋有权随时赎回永续证券。永续证券授予在以下期间收到以下比例分配（Distributions）的权利：自发行日起前三年每年分配率（rate of Distribution）为 4%，如星科金朋未选择行使提前赎回全部永续证券的权利，则第四年起，分配率为 8%，此后每年上升 1%，最高达到 12%。如星科金朋及子公司发生任何债务违约的情况，永续证券的分配率将立刻上升至 12%。

2、担保承诺情况

长电科技作为该永续证券的担保人，出具承诺如下：若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券，永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。

3、公司的债务状况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司短期借款及长期借款（含一年内到期的长期借款）金额分别为 342,474.49 万元和 455,868.54 万元。公司近年来借款规模增长较大主要系公司于 2015 年收购星科金朋及之后星科金朋进行债务重组，以及公司近年来营业规模增加导致营运资金需求量和资本性支出规模提升等因素所致。

4、公司偿债能力

（1）公司已建立完善的资金管理制度

公司具备较完善的资金管理制度，根据公司《预算管理规范》制定年度、月度预算，并根据《筹资管理规范》、《资金管理规范》确定年度资金收支计划，确保所有债务按期偿付。截至本回复出具日，长电科技在偿还银行债务、与客户往来方面不存在违约情况。

（2）公司拥有较为充裕的货币资金储备

截至 2017 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额为 214,776.12 万元，占总资产的比例为 7.00%，该等货币资金可用于资金周转和债务偿付，为公司正常经营和资金流转提供了支持和保障。

（3）公司主要客户商业信用好，经营性现金流充足

报告期公司主营业务稳定发展，营业收入不断增加，主要客户为国际、国内的知名半导体企业，商业信用良好，应收账款周转率高。2015 年、2016 年及 2017 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 174,594.62 万元、266,928.32 万元和 365,724.53 万元，公司稳定提升的经营性现金流为公司未来按时、足额偿付债务本息提供了保证。

（4）公司银行授信额度充裕

截至 2017 年 12 月 31 日，共有 33 家商业银行给予公司授信额度，授信额度总额为 178.69 亿元，其中尚未使用的授信余额为 72.28 亿元；并且公司与国家开发银行、中国进出口银行已经达成在融资方面的战略合作，与国家开发银行江苏省分行签署开发性金融合作备忘录，约定自 2017 年至 2022 年期间，双方在各类

金融产品上的意向合作融资总量为 160 亿元人民币；与中国进出口银行江苏省分行签署战略合作协议，约定自 2017 年起的三年内，在政策允许范围内，中国进出口银行将为公司提供总额不超过 100 亿元人民币或等值美元的信贷支持。

二、结合公司货币资金和信贷状况等分析对上市公司经营的影响

如上文所述，截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有货币资金 214,776.12 万元，占总资产的比例为 7.00%；已取得 178.69 亿元授信额度，其中尚未使用的授信余额为 72.28 亿元。2017 年度，公司实现营业收入 238.56 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 36.57 亿元。而永续证券期末余额为 13.07 亿元（2 亿美元），公司货币资金及现金流量充裕，有充足的银行授信，永续证券的赎回不会对公司经营造成重大不利影响。

13、年报披露，期末衍生金融资产余额为 1859.59 万元，较上年同期 58.71 万元大幅增长 3067.40%，其中主要为远期结售汇交易。请公司补充披露衍生金融资产中远期结售汇交易变动发生的业务背景、具体情况、大幅变动的原因及合理性。

回复说明：

星科金朋及其子公司 SCK 位于新加坡和韩国，其绝大部分销售均为出口销售并以美元计价，公司在未来期间将因销售活动而收到美元货款，而基于日常经营需要，其工薪费用、租金及能源费用等均需以当地货币支付。

为了应对预期的未来现金流波动带来的风险敞口，星科金朋管理层建立了风险管控体制，通过使用衍生工具，与多家银行签订远期外汇合同，约定在一定期间内，按约定的汇率向各家银行卖出一定金额的美元，对由于在一些国家经营而受到的外汇汇率变动的风险进行套期。因为预测套期保值交易具有很高的可能性，公司将上述远期外汇合同指定为针对预期支付的工薪费用、租金及能源费用相关的现金流即确定性承诺进行的套期保值，也因此将上述套期业务划分为现金流套期。

本年美元对韩元的汇率处于下降趋势，于本年年末现金流套期形成衍生金融资产。去年年末美元对韩元汇率处于上升趋势，于去年年末现金流套期形成衍生金融负债。去年年末衍生金融资产余额系黄金租赁产生的衍生金融资产。本年黄金租赁已归还，本年年末无黄金租赁产生的衍生金融资产余额。

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日